

2012年3月期 中間決算会社説明会

2011年11月

TOWA株式会社

第2四半期(累計)業績概要

(百万円)

	期初 上期予想	6/23 修正	10/28 修正	上期 実績
売上高	9,000	9,000	7,810	7,813
営業利益	550	550	760	764
経常利益	500	500	570	571
当期純利益	450	▲110	▲40	▲36

通期業績予想

(百万円)

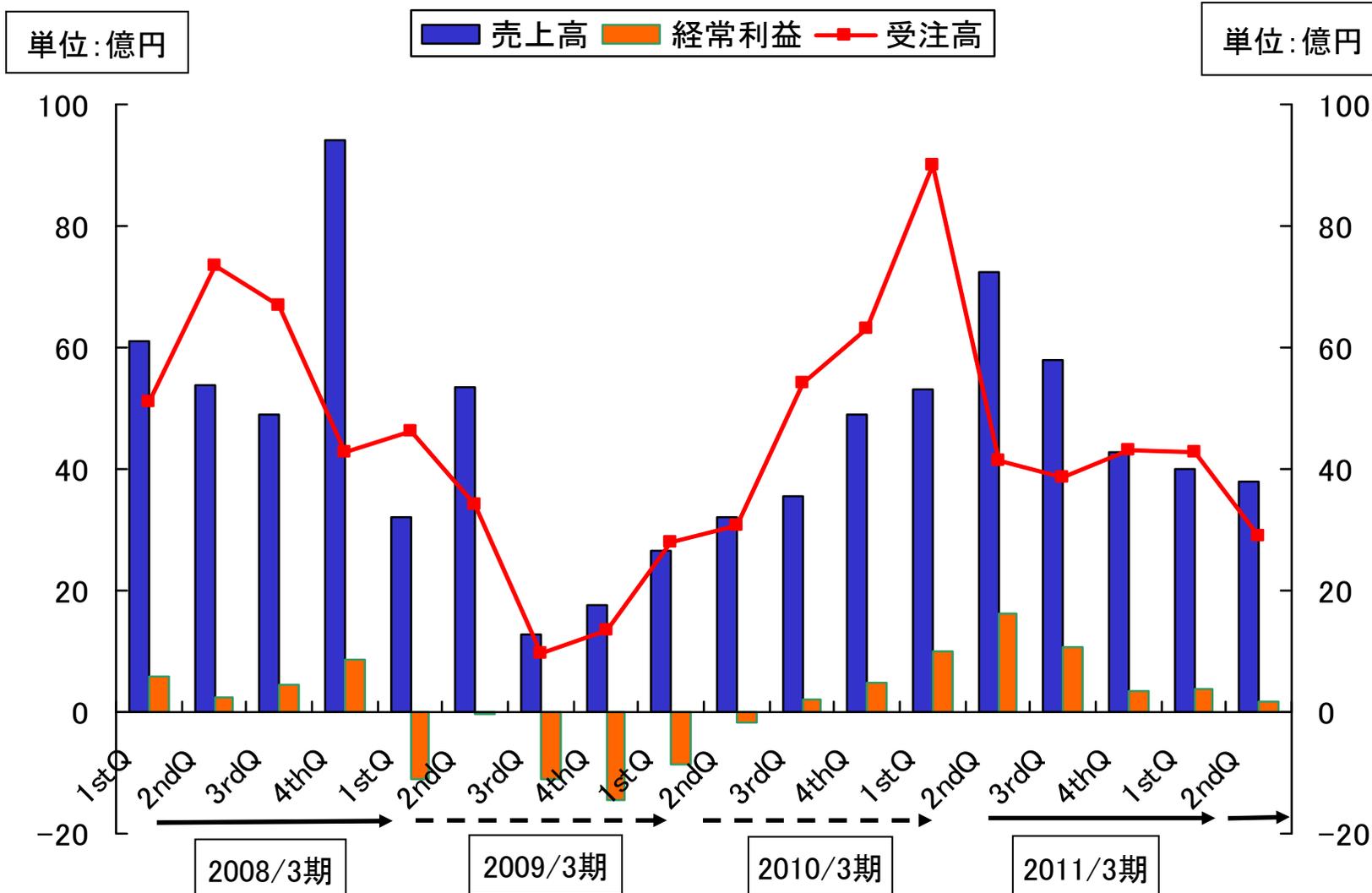
	期初 通期予想	期初 下期予想	10/28 下期修正	10/28 通期修正
売上高	19,000	10,000	7,200	15,010
営業利益	1,300	750	420	1,180
経常利益	1,200	700	370	940
当期純利益	1,100	650	370	330

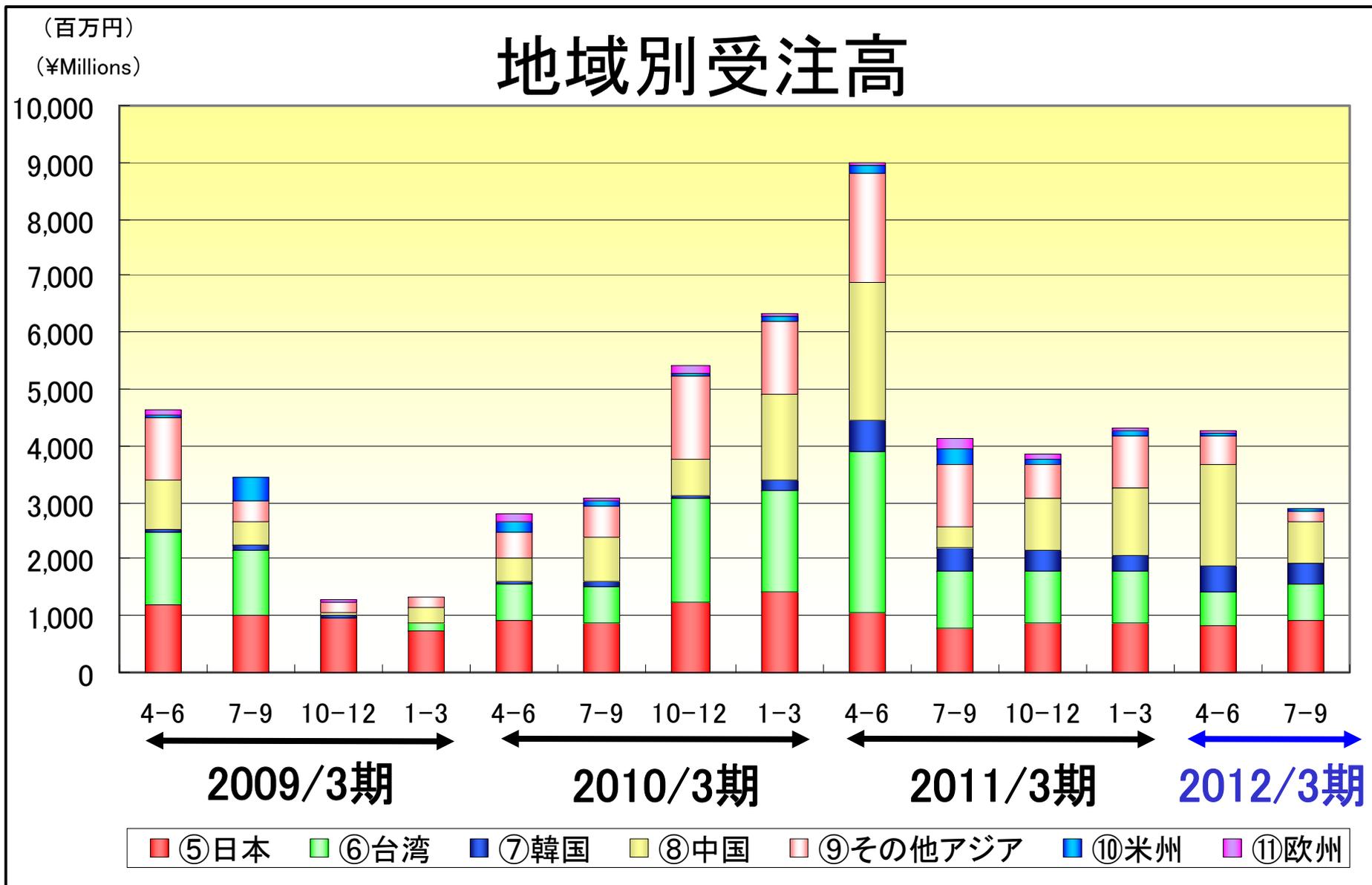
配 当 の 状 況

(円. 銭)

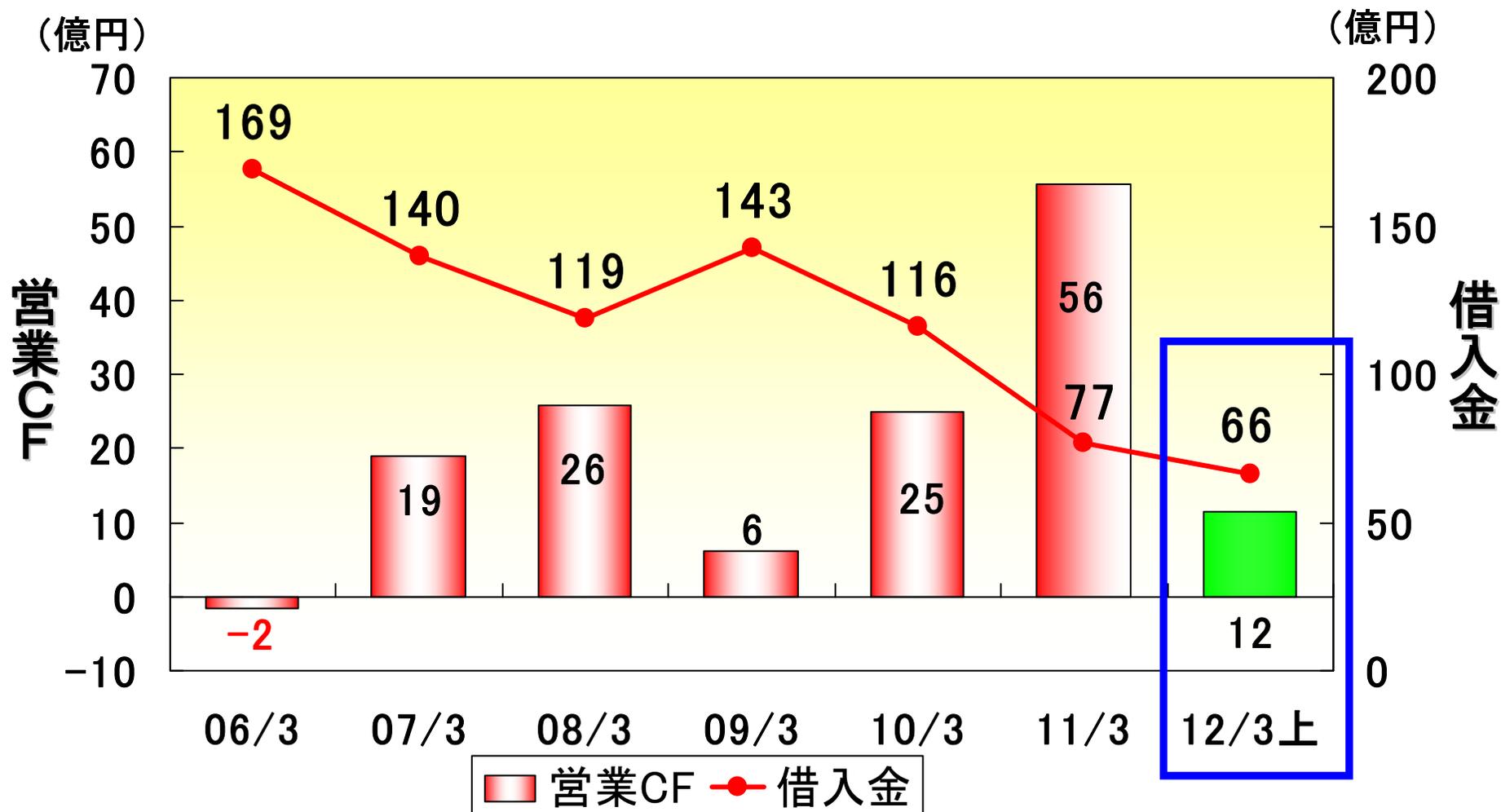
	中間	期末 (予定)	合計
2012年3月期	0. 00	5. 00	5. 00
(参考) 2011年3月期	0. 00	10. 00	10. 00

受注高・売上高・経常利益推移

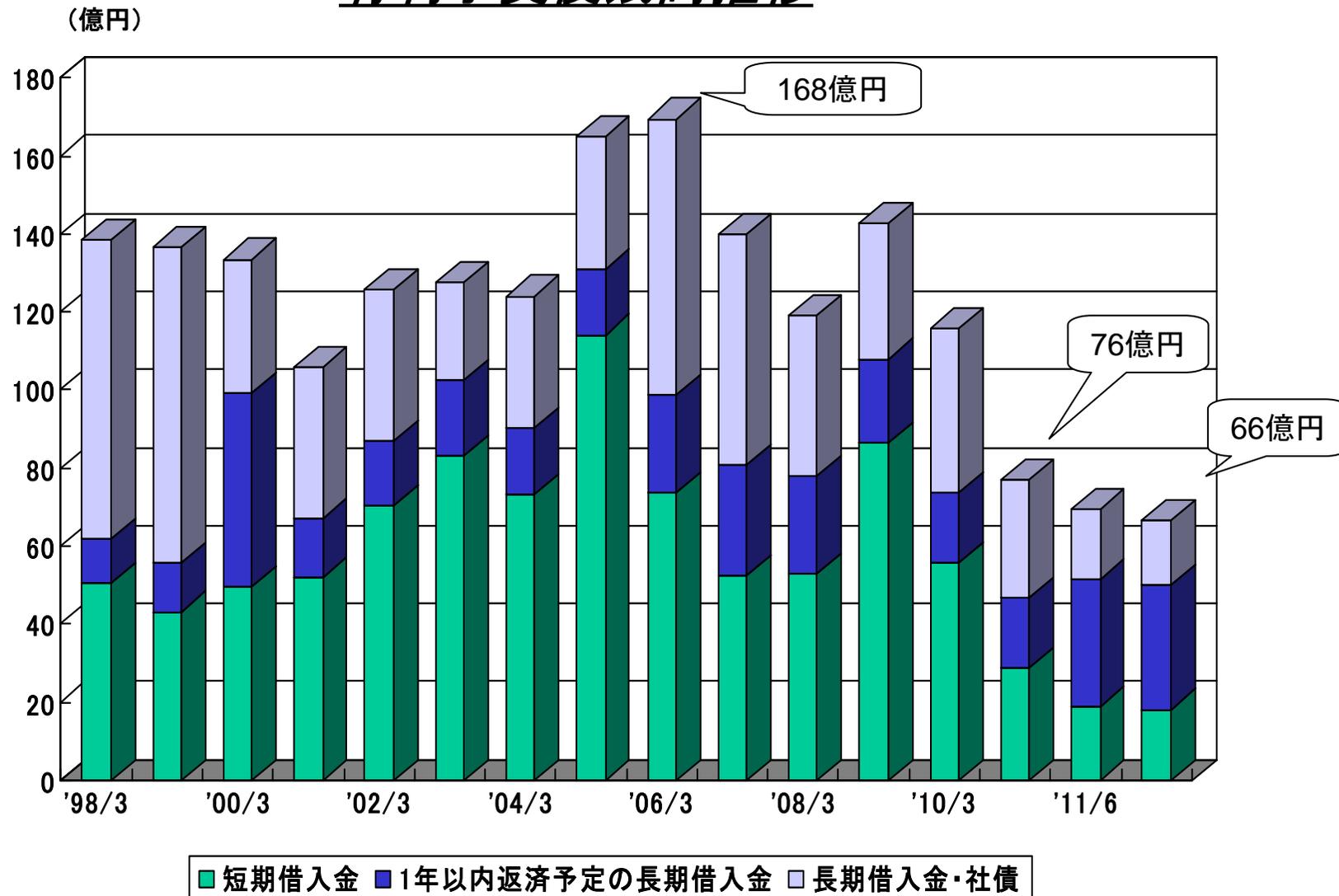




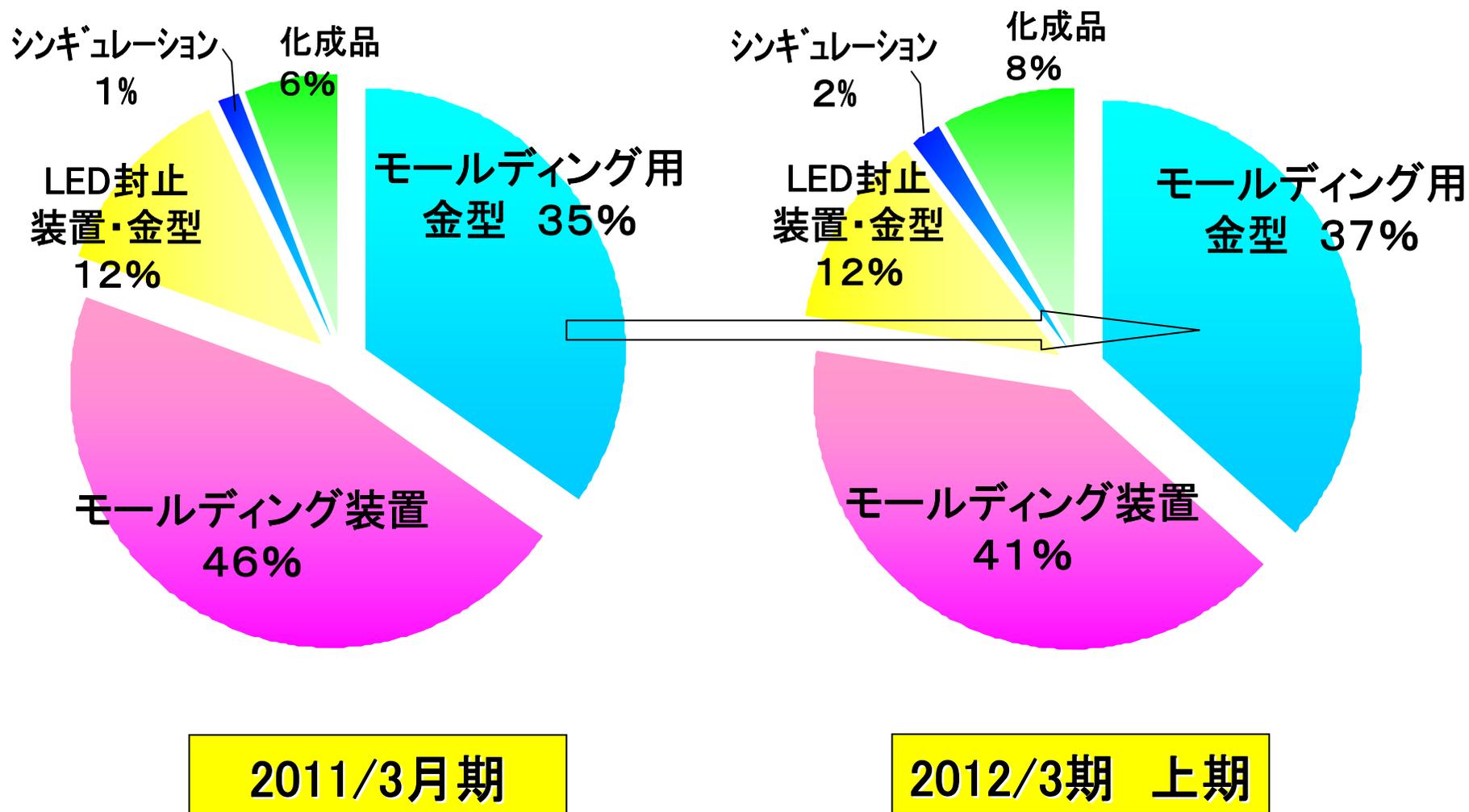
営業キャッシュフロー・借入金推移



有利子負債残高推移



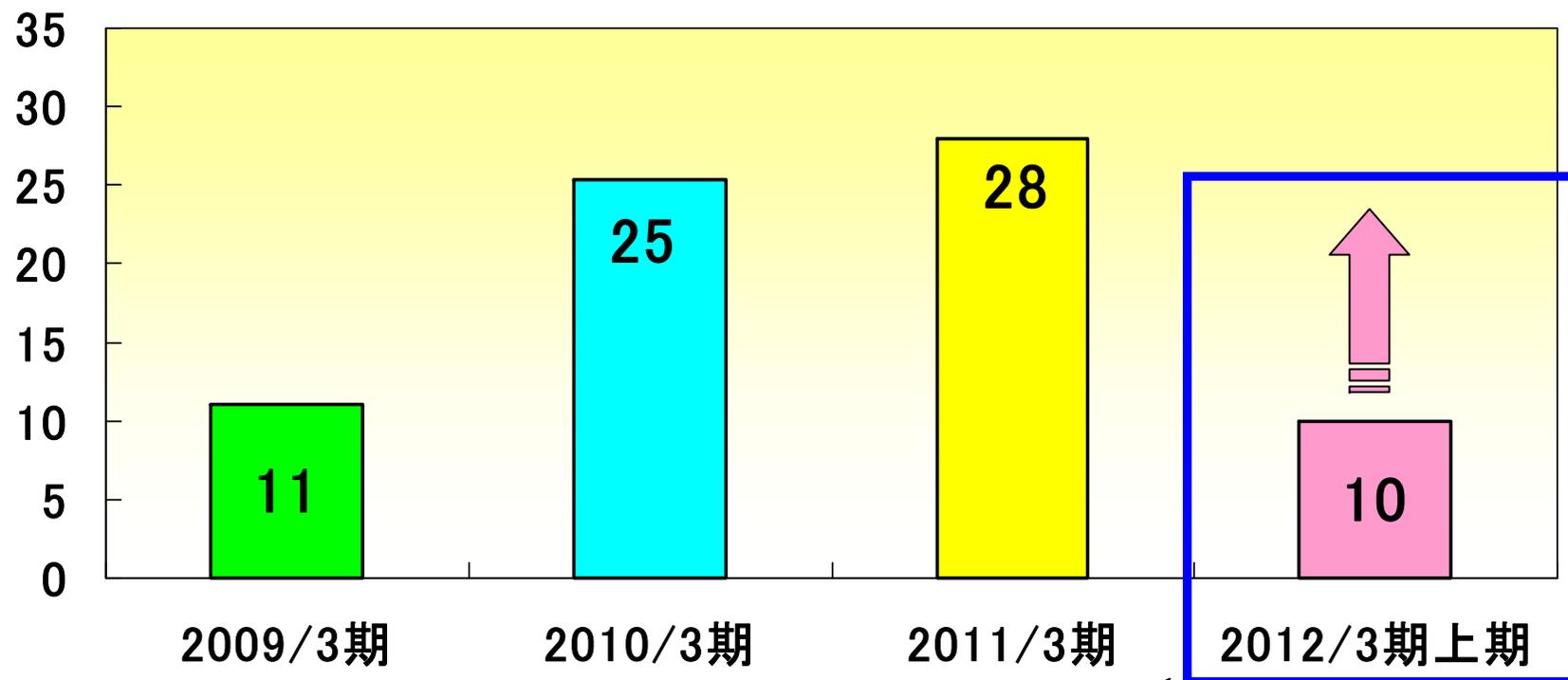
製品別売上高構成



LED樹脂封止用装置・金型

売上高推移

(億円)



照明用のLED

上期のサマリー

●震災の影響は軽微

☆自社設備への影響等 ⇒ なし

☆各半導体メーカー ⇒ 想定以上に早く復旧(7月)

☆電力使用制限 ⇒ ほぼ影響なし

●家電、電子機器の市況は今ひとつ

☆サプライチェーン ⇒ 在庫積みあがる(PCは顕著、TVも減速)

☆季節要因 ⇒ 弱い(クリスマス、年末商戦・・・盛り上がりせず)

☆欧米ソブリンリスク ⇒ **さらなる個人消費減速へ警戒感**

●半導体業界

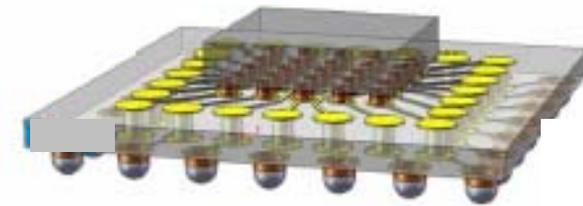
☆新技術への投資には各社積極的

○ 3D SiP、TSV、30nm、20nm DRAM量産

○ パワー半導体 ⇒ SiC PKG、省電力用途(エコカー、スマートグリッド)

☆ディスクリート系は減速

☆スマホ・タブレット関連(NANDフラッシュ等)は好調



●LED業界

☆LEDメーカーの設備投資 横ばい ⇒ やや減速(BL用途チップ供給過剰)

☆中国マーケット ⇒ 補助金のストップ、金融引き締めの影響

☆BL用途 ⇒ 照明用へ大きく転換

☆パッケージング工程は様々な形態を模索している段階

上期の主な取組み

(1) 製品開発

☆小型・高精密プレス装置(大判化対応)の開発

☆WLPへの対応

☆自社製ダイサー搭載のシンギュレーション装置開発



(2) コンプレッションモールドの市場浸透

☆評価機の貸し出し、成型サンプル取り

☆成型材料別歩留まり率など生産性分析を提供

☆トランスファー装置既納先へスイッチングを仕掛ける

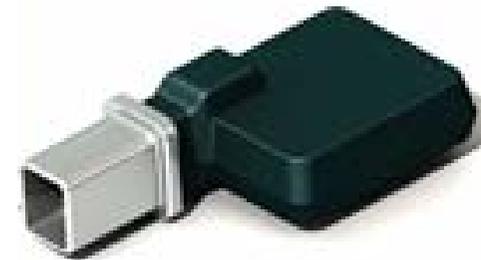


(3) LEDの新規顧客開拓

☆中国ローカルの開拓

☆各ニーズへの対応

- ・リフレクター成型
- ・レンズ成型
- ・COB対応



(4) 新分野へのチャレンジ

- | | | |
|-------|-------|--------------------|
| ☆電子部品 | 単品 | ⇒ モジュール化(一括成型) |
| | ケーシング | ⇒ 樹脂封止部品 |
| ☆車載部品 | 統合制御 | ⇒ 各部での単独制御化(ECUなど) |
| | 搭載部品 | ⇒ 高機能化・モジュール化 |

(5) ファインプラスチック成型品事業の生産能力アップを計画

山梨県韮崎市龍岡町下條南割

敷地面積 8,581m² (2,600坪)

(6) 持分法適用関連会社の異動(譲渡)

保有するSecron Co.,Ltdの全株式をSamsung Electronicsへ売却

CASH IN 約600百万円

会計処理 (連結)売却損失 ▲559百万円

(個別)売却益 +550百万円

(7) TOWA America 不動産売却

①売却物件 TOWA America 工場および倉庫
(土地) 23,764m²
(建物) 4,422m²

②売却額 US\$4,200,000

③損益への影響 (第3四半期に計上予定)
特別損失 US\$243,351

④その他

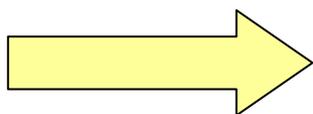
すでに生産事業会社から販売事業会社へ業態変更しており、本件による当社グループ事業への影響はありません。

下期について

半導体事業（下期見通し）

☆ 各社とも現有設備の稼働率引き上げで対応可能

☆ 本格的な設備投資は4Q(来年1月)以降

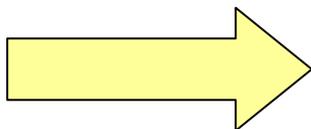


足踏み状態、ボリュームは縮小

(BEポイントは下がっており利益確保は可能)

☆ 新しいPKGの試作、評価等は活発

☆ 好調なアプリケーション用途は引き続き高い稼働率

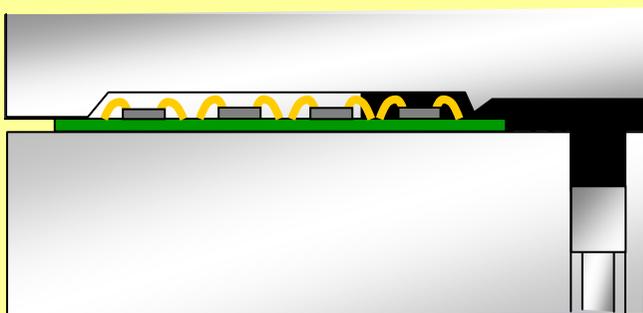


PKG開発段階からユーザーと協働

コンプレッション方式の優位性が顕著に

コンプレッションモールドの特徴

従来のトランスファ成形

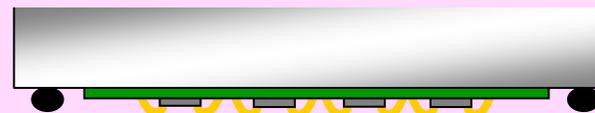


プランジャによって樹脂を流す成形法
微細隙間, 微細ロングワイヤ, 大面積
パッケージの成形が難しい

顆粒樹脂・・・BGA、WLP

液状樹脂・・・チップLED

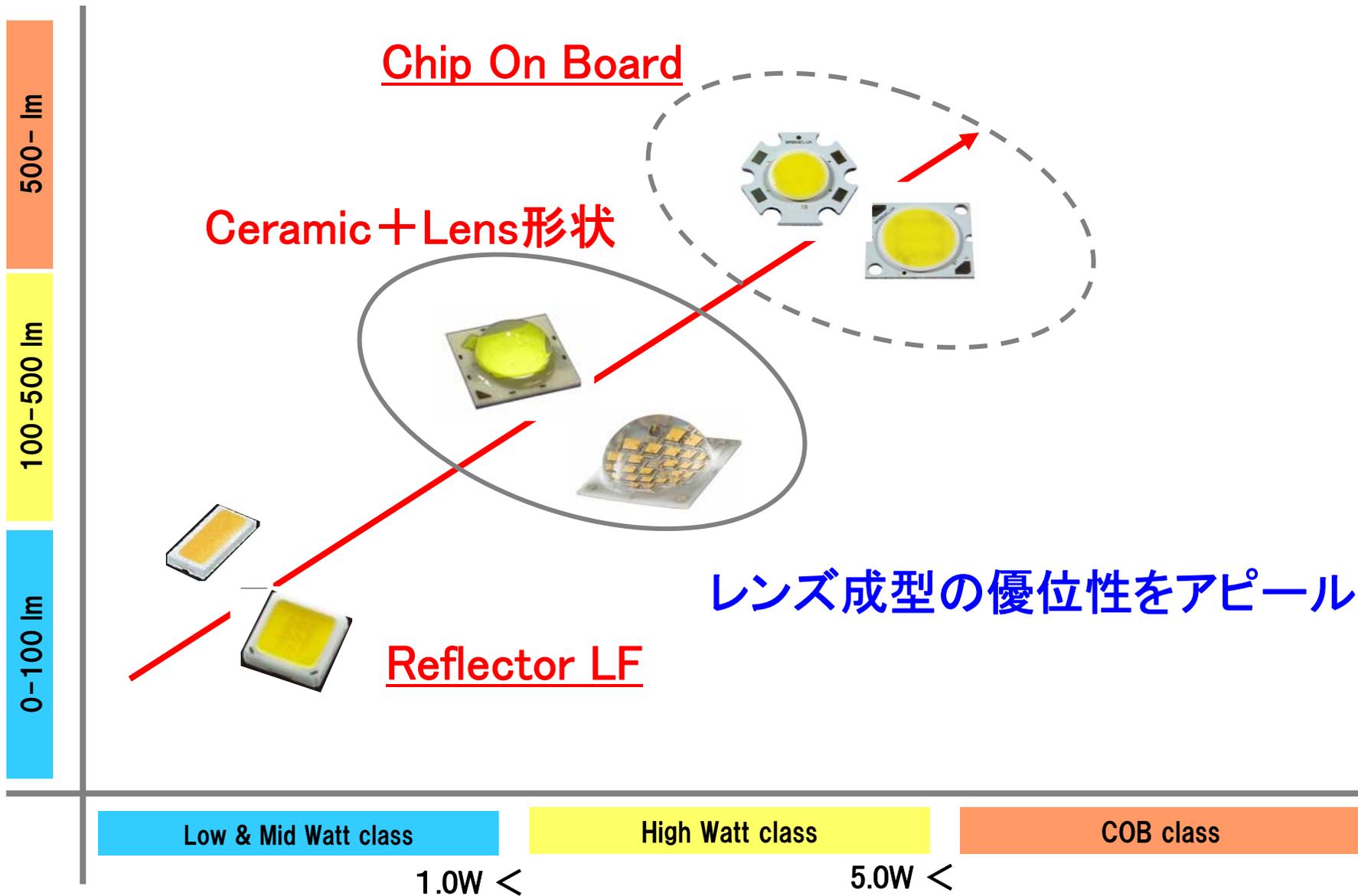
コンプレッションモールド成形



樹脂を流さない圧縮成形法

微細隙間, 微細ロングワイヤ, 大面積
パッケージの成形が容易

LED事業（下期見通し）



下期の主な取組み

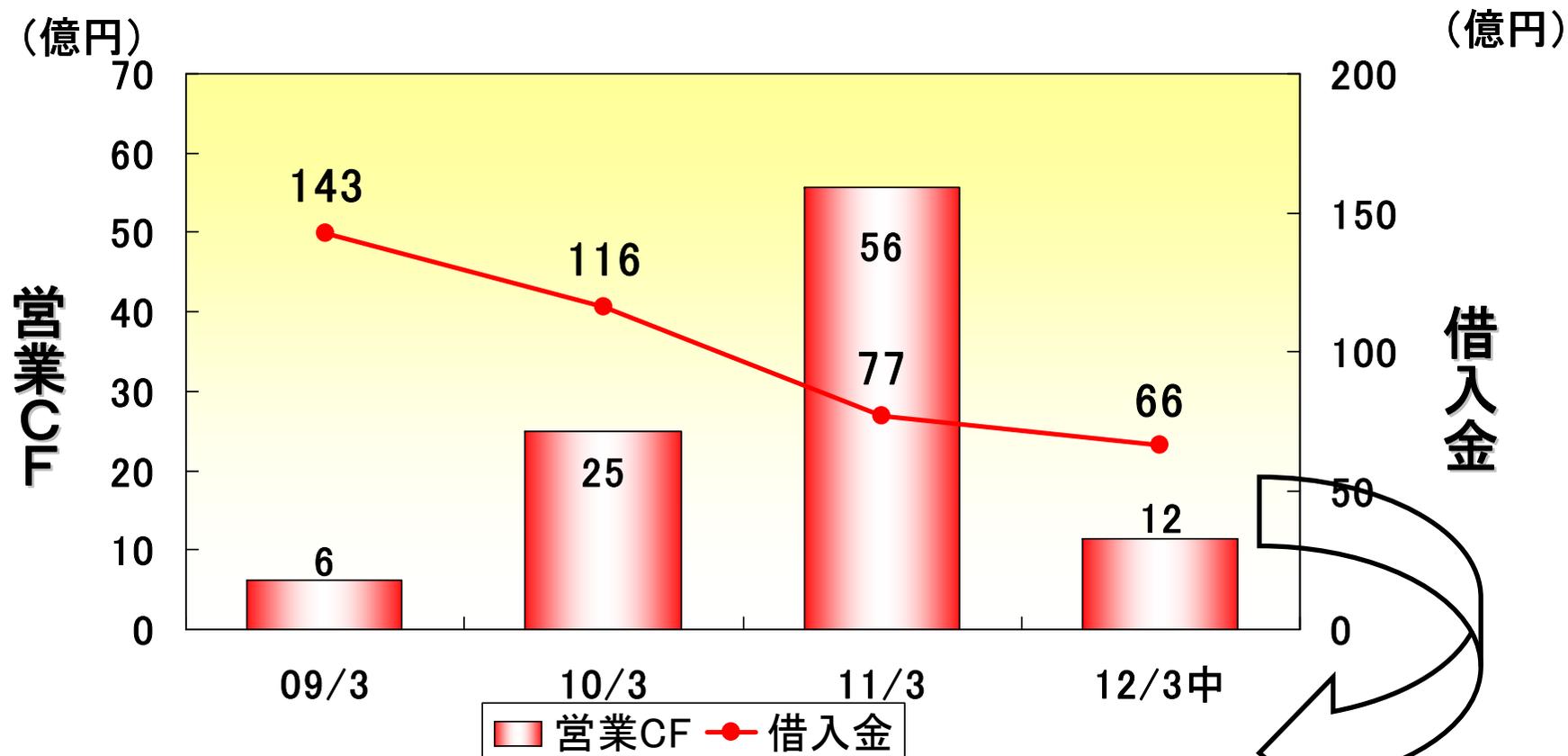
☆更なる競争力アップへ

- ・コンプレッション方式の浸透活動
- ・顧客との協働PKG開発(人的リソースも投入)
- ・生産技術の洗練、コストダウン設計による原価低減
- ・開発設計にリソースを傾斜配分

☆LED事業の巻き返し

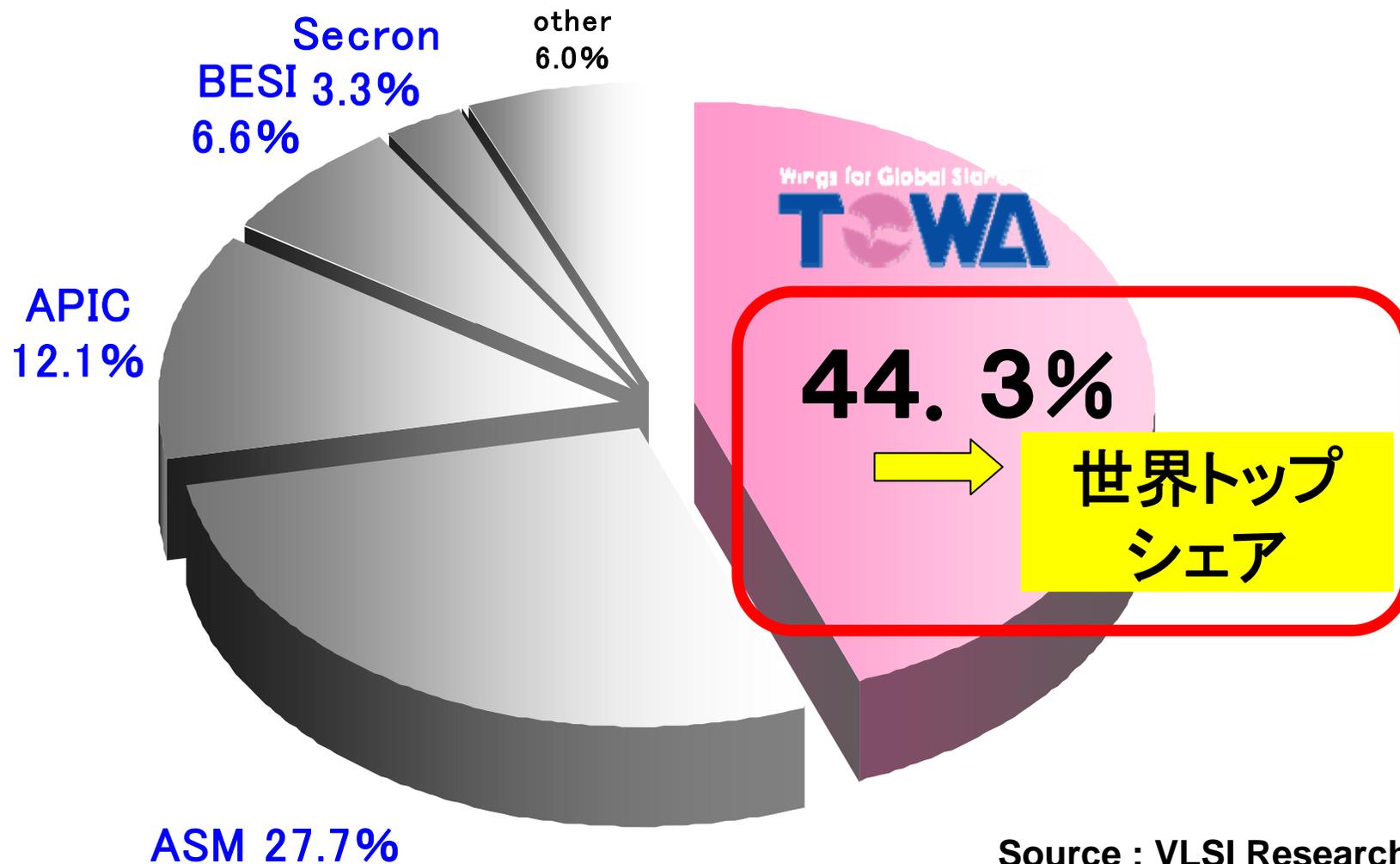
- ・リフレクター成型、レンズ成型、COBへ対応
- ・樹脂混合、ダイシング等を含めた総合提案
- ・新規顧客の開拓

営業キャッシュフロー・借入金推移



中計期間中(2014/3期まで)に
(ネット)無借金化を目指す

2010年度 世界オートモールド装置市場シェア



プライベートショー開催

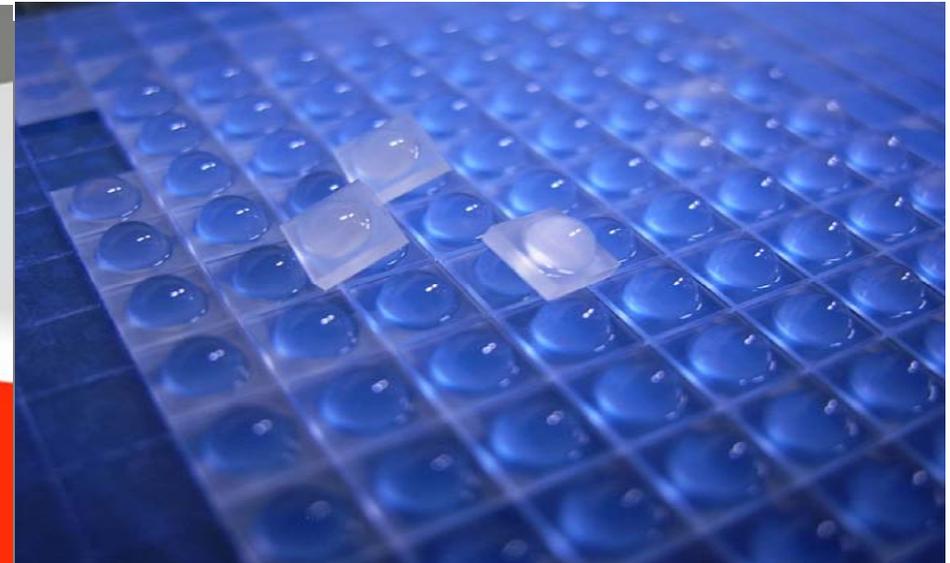
2011年12月7日～12月21日
主要ユーザー様を本社へご招待

機関投資家様・アナリスト様向け説明会
12月13日(火)、16(金)開催



展示内容

- ☆ YPM (大判対応装置、Side, Top/Edgeゲート対応)
(車載向クリーン仕様)
- ☆ PMC (コンプレッションモールド装置)
- ☆ FMS (自社製ダイサー搭載シンギュレーション装置)
- ☆ LCM (LED樹脂封止装置)



新製品 YPM1150

大判化対応トランスファーマーモルディング装置

☆対応リードフレーム : 100mm×300mm

☆中央加圧方式(ホールドフレーム構造を採用)

☆Side gate, Top/Edge gate 全てに対応可能



☆独自の小型・高精密プレス機構

☆大判化対応装置ながら
フットプリントは大幅に抑制

☆変形量の抑制

☆有効盤面の極大化が可能

新製品 FMS3040

シンギュレーションシステム(個片化装置)

TOWAが世界シェアトップの“モールディング”の次工程であるシンギュレーションプロセスに新装置を投入する。



- ☆ 自社製ダイサーを搭載
- ☆ カット品質と速度の大幅向上
- ☆ UPH 30000(業界最高水準)

PMC -D (ダブルレイヤー)

コンプレッションモールディング装置

TOWA独自のコンプレッション技術とモジュール方式を融合
ホールドフレーム構造を採用したプレス機構



☆大型基板の一括成形

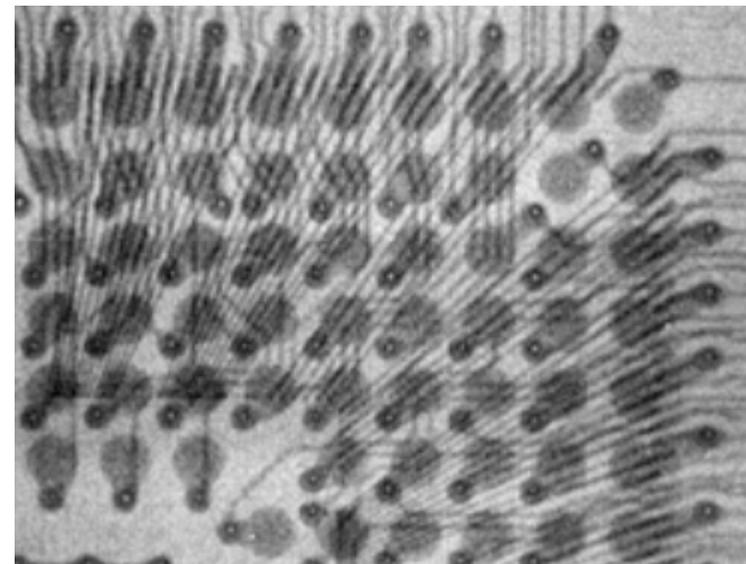
☆ロング微細ワイヤーのワイヤーフロー
対策に最適

コンプレッションモールドのメリット①

コンプレッションモールドでは樹脂流動が極めて少ないため、金線ワイヤーの細線化が可能。

● 微細ロングワイヤーでの成形評価例

【成形条件】
ワイヤー径: $\phi 15 \mu\text{m}$
ワイヤー長さ 5mm



● 金線ワイヤー細線化によるコストダウン試算

$\phi 25 \mu\text{m} \Rightarrow \phi 15 \mu\text{m}$	約64%の削減
$\phi 22 \mu\text{m} \Rightarrow \phi 15 \mu\text{m}$	約54%の削減

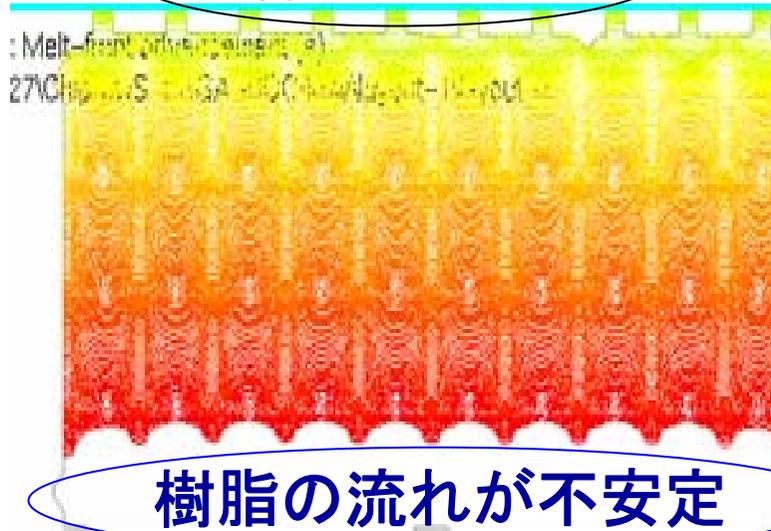
※断面積比

ワイヤー細線化による金線コストを低減

コンプレッションモールドのメリット②

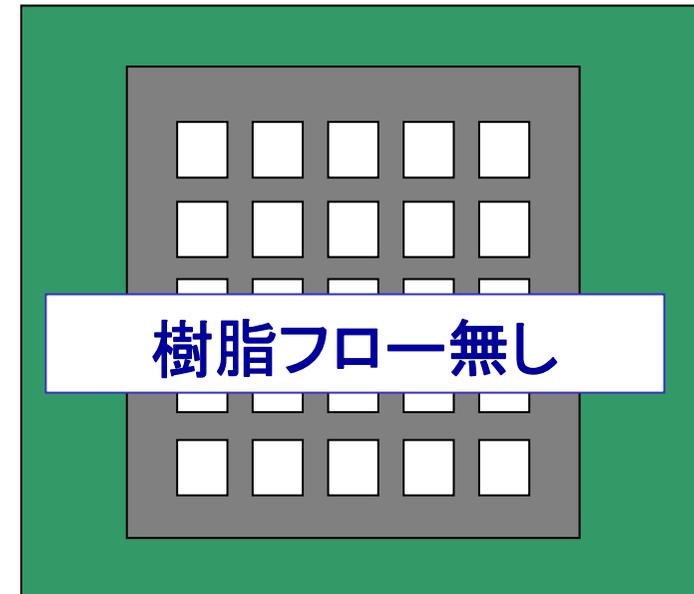
トランスファーモールド

樹脂の注入側



樹脂の流れが不安定

コンプレッションモールド



樹脂フロー無し

<大型基板への対応>

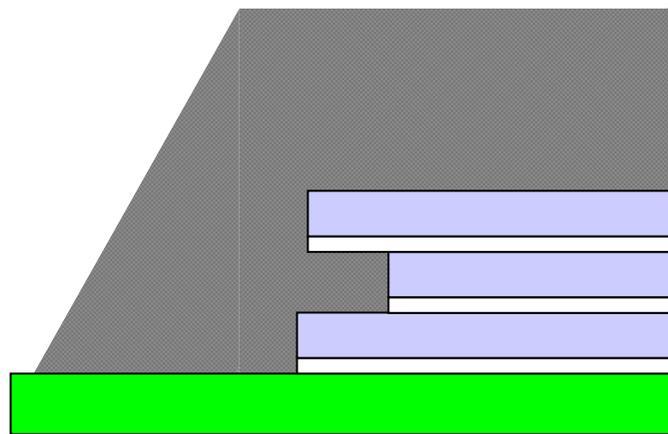
トランスファーモールド・・・樹脂流動が大きくなり、注入時間が掛かる→成形品質が安定しない

コンプレッションモールド・・・樹脂流動が無く、成形時間を短縮化→**高品質な成形が可能**

コンプレッションモールドのメリット③

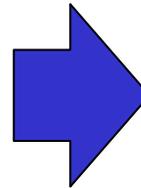
トランスファーモールドではチップ上の樹脂厚みを確保するため、バック・グラインディング及びCMP工程によるウエハー研削が必要。

ウエハー研削を行い、薄型化

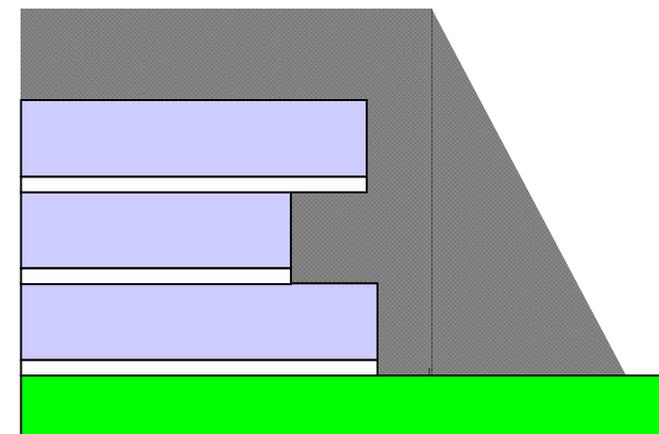


トランスファーモールド

樹脂の通り道が必要



ウエハー研削工程を短縮

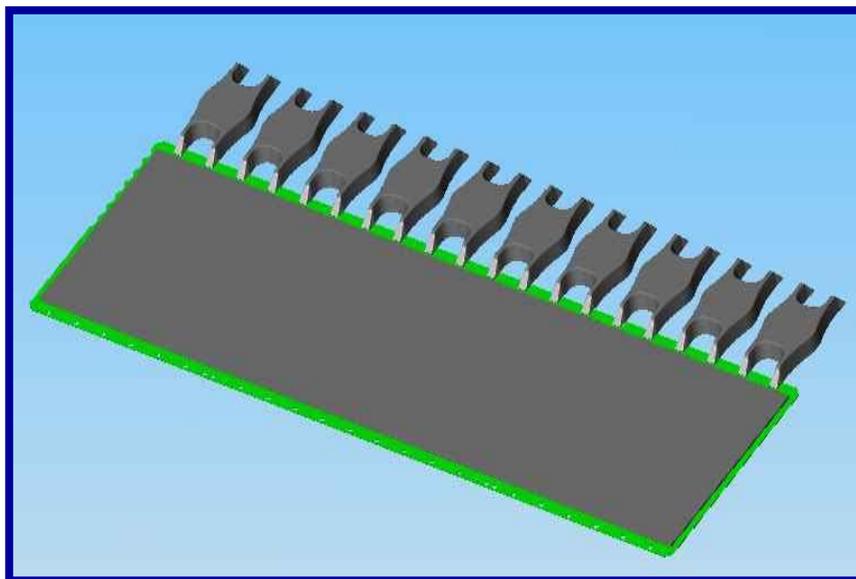


コンプレッションモールド

ウエハー研削工程のプロセス時間の短縮化を図り、
更にCMP工程の省略も可能となる。

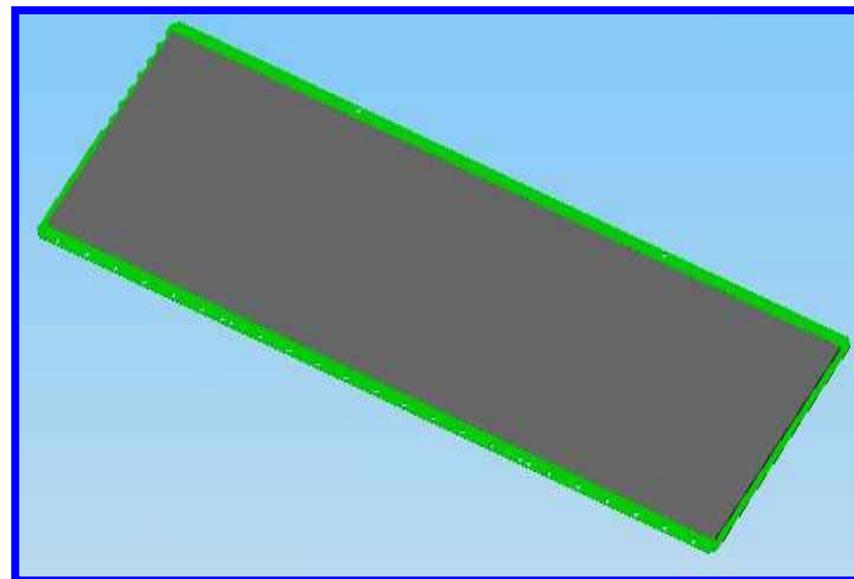
コンプレッションモールドのメリット④

トランスファーモールド



樹脂歩留り約40～60%

コンプレッションモールド



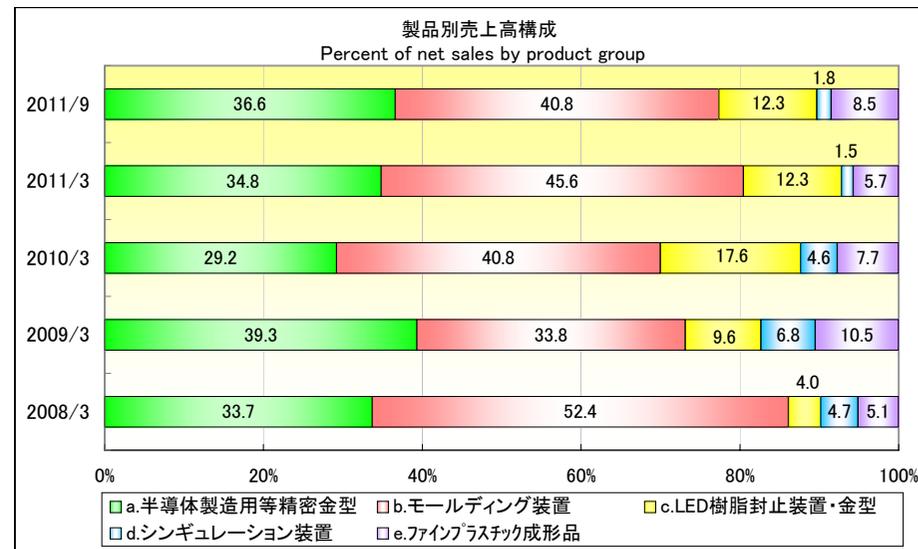
カル・ランナー・ゲートレスにより
樹脂歩留り約100%

樹脂使用量および産業廃棄物を削減

中期経営指針

成長を続ける企業となるために
必要な“仕組み”を構築する

I. 決算概況(連結) Operating Results (Consolidated)

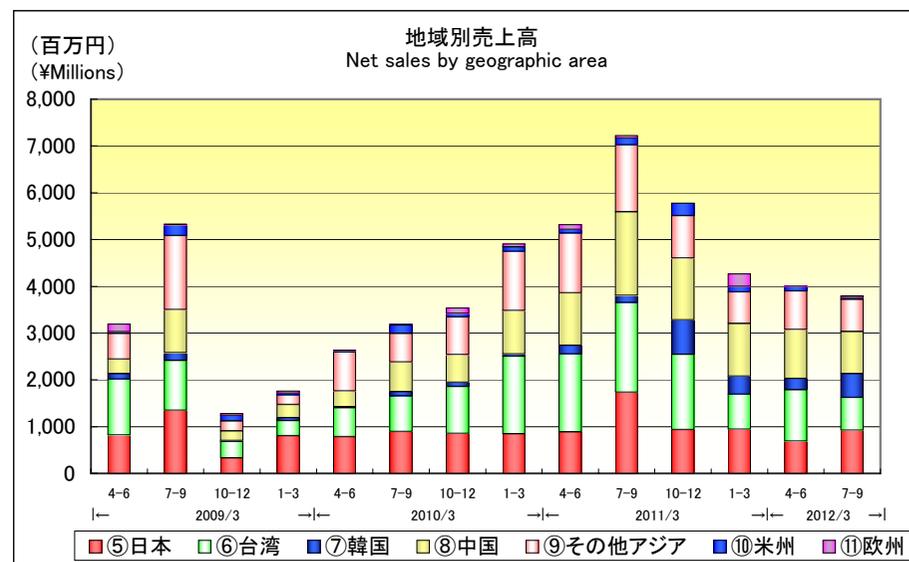
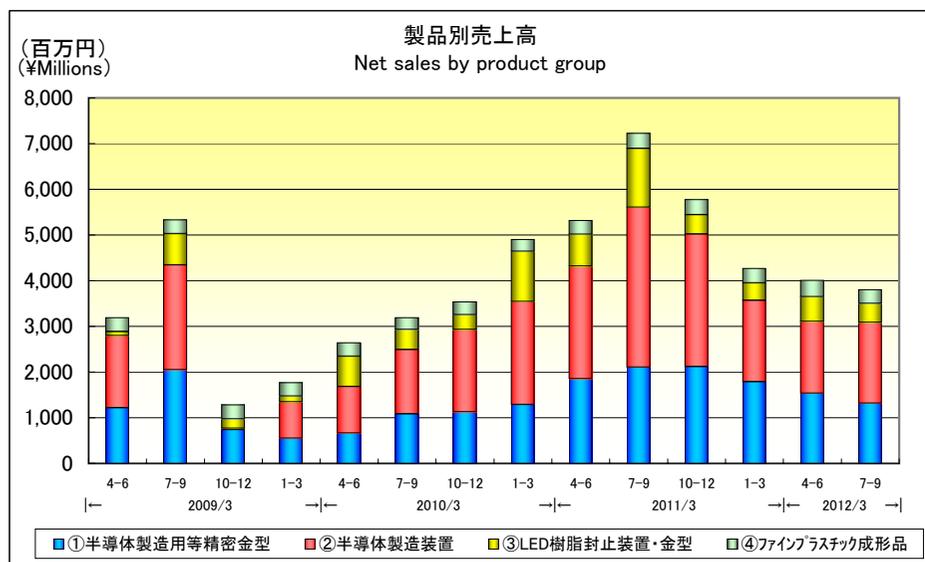


a.Precision molds b.Semiconductor plastic encapsulation systems c.Semiconductor plastic encapsulation systems for LED
d.Singulation parts and systems e. Engineering plastic molded products

決算期		2008/3	2009/3	2010/3	2011/3	2012/3E
経営成績・財政状態	Operating results and financial conditions					
売上高	①Net sales	25,753	11,577	14,274	22,592	15,010
営業利益	Operating income	2,381	-3,337	-338	4,067	1,180
経常利益	Ordinary income	2,125	-3,677	-345	4,064	940
当期純利益	Net income	2,118	-4,163	-330	3,751	330
総資産	Total assets	34,360	27,949	26,738	27,288	-
純資産	Net assets	16,394	11,089	11,091	14,771	-
1株当たり指標	Per share data					
1株当たり当期純利益	Net income per share	84.70	-166.45	-13.19	150.00	13.19
諸指標	Data					
自己資本当期純利益率	Return on equity	13.5	-30.3	-3.0	29.0	-
総資産経常利益率	Ordinary income to total assets	6.1	-11.8	-1.3	15.0	-
売上高営業利益率	②Operating income to net sales	9.2	-28.8	-2.4	18.0	7.9
自己資本比率	Equity ratio	47.7	39.7	41.5	54.1	-

(単位: 百万円/¥Millions)		
	2010/9	2011/9
売上高	12,544	7,813
営業利益	2,691	764
経常利益	2,625	571
当期純利益	2,515	-36
総資産	28,378	25,637
純資産	13,291	14,531
1株当たり当期純利益	100.55	-1.44
自己資本当期純利益率	20.6	-0.2
総資産経常利益率	9.5	2.2
売上高営業利益率	21.5	9.8
自己資本比率	46.8	56.7

II. 四半期売上動向(連結) Quarterly Net Sales (Consolidated)



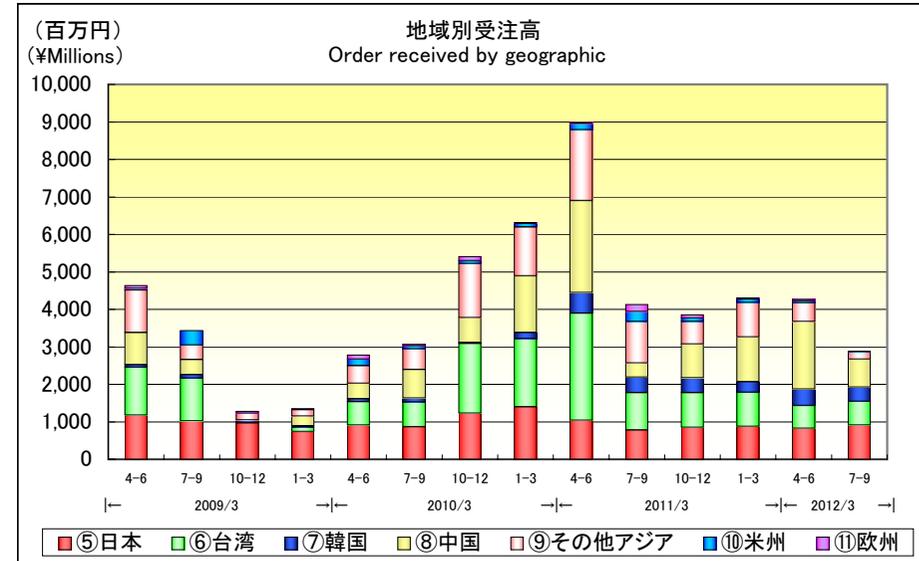
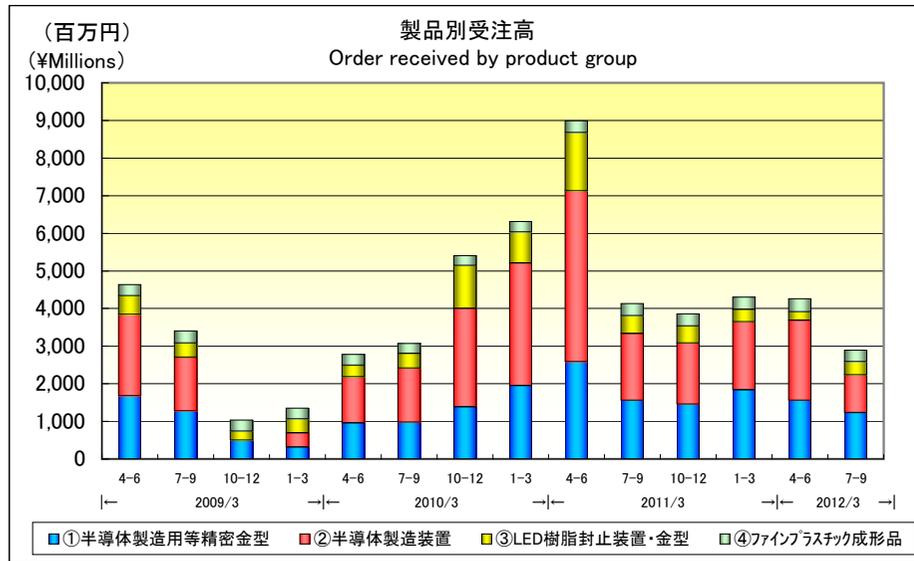
製品別売上高 Net sales by product group

決算期	2009/3					2010/3					2011/3					2012/3		
	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	上期
売上高合計 Total sales	3,192	5,335	1,283	1,767	11,577	2,641	3,190	3,537	4,905	14,274	5,317	7,227	5,777	4,271	22,592	4,009	3,803	7,813
半導体製造用等精密金型 ①Precision molds	1,218	2,046	739	547	4,552	665	1,086	1,127	1,287	4,167	1,852	2,104	2,121	1,787	7,866	1,537	1,320	2,857
半導体製造装置 ②Semiconductor manufacturing equipment	1,575	2,299	29	796	4,700	1,021	1,407	1,801	2,253	6,484	2,462	3,499	2,902	1,786	10,651	1,568	1,761	3,330
LED樹脂封止装置・金型 ③Semiconductor plastic encapsulation systems for LED	95	681	202	128	1,107	659	435	325	1,100	2,520	698	1,290	420	377	2,786	544	418	963
ファインプラスチック成形品 ④Engineering plastic molded products	302	307	310	295	1,217	293	261	283	263	1,102	304	332	332	319	1,289	359	303	662
月平均	1,064	1,778	428	589	965	880	1,063	1,179	1,635	1,190	1,772	2,409	1,926	1,424	1,883	1,336	1,268	1,302

地域別売上高 Net sales by geographic area

決算期	2009/3					2010/3					2011/3					2012/3		
	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	上期
売上高合計 Total sales	3,192	5,335	1,283	1,767	11,577	2,641	3,190	3,537	4,905	14,274	5,317	7,227	5,777	4,271	22,592	4,009	3,803	7,813
日本 ⑤Japan	820	1,347	329	805	3,302	782	892	856	847	3,379	889	1,735	936	943	4,507	688	925	1,614
アジア太平洋 Asia pacific	2,177	3,740	794	876	7,587	1,811	2,100	2,492	3,900	10,305	4,253	5,290	4,572	2,938	17,060	3,215	2,797	6,013
(内 台湾) ⑥Taiwan	1,195	1,067	355	325	2,943	618	763	1,002	1,660	4,044	1,661	1,920	1,611	751	5,945	1,103	695	1,799
(内 韓国) ⑦Korea	118	166	18	58	362	22	92	92	45	253	187	152	737	380	1,458	237	510	748
(内 中国) ⑧China	309	919	209	287	1,726	341	635	585	926	2,490	1,125	1,786	1,319	1,130	5,363	1,050	903	1,954
(内 その他アジア) ⑨Other asia	553	1,587	210	204	2,555	829	608	811	1,267	3,516	1,279	1,431	904	675	4,291	823	688	1,511
米州 ⑩America	31	226	115	36	409	29	182	74	95	382	70	145	268	117	602	94	32	127
欧州 ⑪Europe	163	21	44	49	277	17	14	113	62	207	103	55	0	270	423	10	47	58

Ⅲ. 四半期受注動向(連結) Quarterly Order (Consolidated)



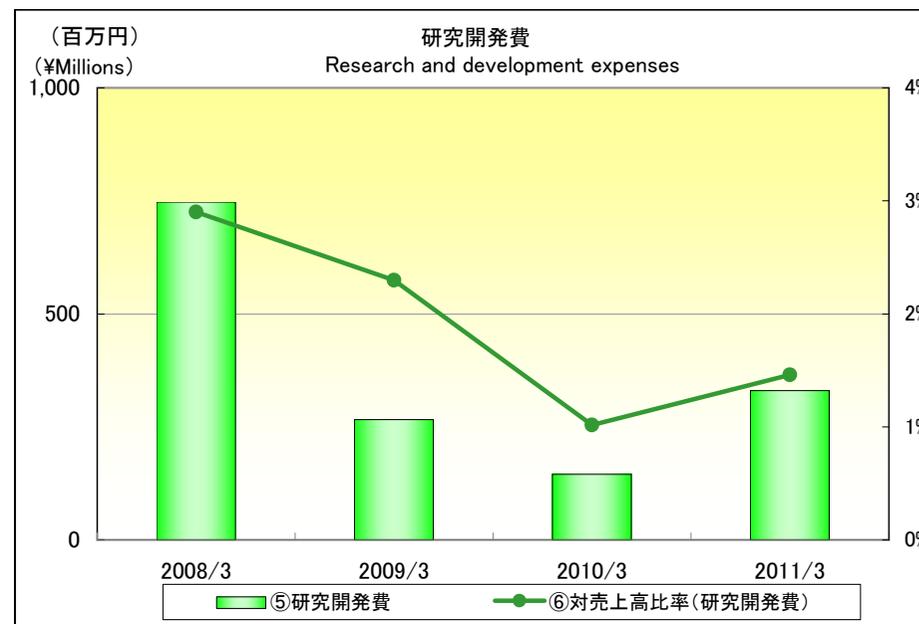
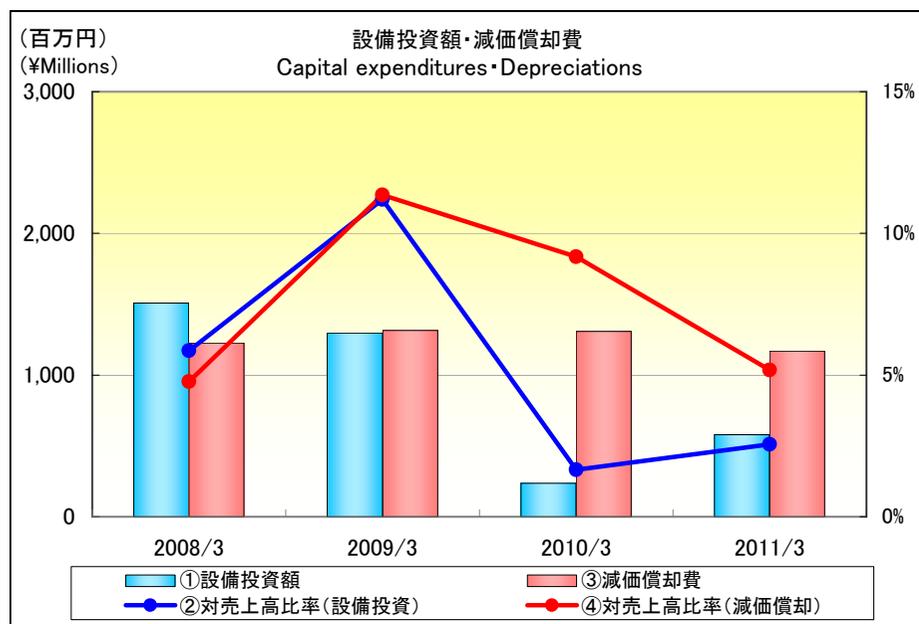
製品別受注高 Order received by product group

決算期	2009/3					2010/3					2011/3					2012/3		
	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	上期
受注高合計 Total order received	4,635	3,410	951	1,351	10,350	2,786	3,070	5,407	6,316	17,581	8,989	4,132	3,858	4,304	21,285	4,265	2,891	7,157
半導体製造用等精密金型 ①Precision molds	1,679	1,275	498	314	3,767	961	976	1,383	1,951	5,273	2,587	1,554	1,455	1,841	7,438	1,558	1,236	2,795
半導体製造装置 ②Semiconductor manufacturing equipment	2,166	1,431	-82	376	3,892	1,217	1,433	2,618	3,255	8,524	4,539	1,784	1,622	1,800	9,746	2,128	998	3,127
LED樹脂封止装置・金型 ③Semiconductor plastic encapsulation systems for LED	492	376	234	372	1,477	311	395	1,138	827	2,673	1,546	465	454	335	2,801	227	348	576
ファインプラスチック成形品 ④Engineering plastic molded products	296	326	301	288	1,212	295	264	267	282	1,110	316	327	326	327	1,298	350	307	658
月平均	1,545	1,137	317	450	863	929	1,023	1,802	2,105	1,465	2,996	1,377	1,286	1,435	1,774	1,422	964	1,193

地域別受注高 Order received by geographic area

決算期	2009/3					2010/3					2011/3					2012/3		
	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	上期
受注高合計 Total order received	4,635	3,410	951	1,351	10,350	2,786	3,070	5,407	6,316	17,581	8,989	4,132	3,858	4,304	21,285	4,265	2,891	7,157
日本 ⑤Japan	1,178	1,024	966	742	3,911	910	863	1,229	1,400	4,404	1,038	781	853	875	3,548	821	906	1,727
アジア太平洋 Asia pacific	3,339	2,026	-47	578	5,897	1,590	2,083	3,995	4,801	12,471	7,753	2,893	2,825	3,311	16,783	3,356	1,960	5,316
(内 台湾) ⑥Taiwan	1,277	1,135	-307	118	2,223	627	667	1,858	1,823	4,976	2,863	992	921	913	5,691	615	642	1,257
(内 韓国) ⑦Korea	70	100	61	32	266	75	97	31	160	364	546	415	395	277	1,635	435	375	811
(内 中国) ⑧China	854	404	18	254	1,531	415	764	663	1,507	3,351	2,456	376	907	1,198	4,938	1,801	746	2,547
(内 その他アジア) ⑨Other asia	1,136	386	180	172	1,875	471	554	1,442	1,310	3,778	1,886	1,108	601	921	4,518	503	196	700
米州 ⑩America	39	386	-22	7	410	175	74	73	93	417	168	268	95	90	623	44	19	64
欧州 ⑪Europe	78	-27	55	23	130	109	48	108	20	287	29	188	84	26	329	43	4	48

IV. キャッシュフロー、設備投資額、研究開発費(連結) Cash Flows and Capital Expenditures, Research and Development expenses (Consolidated)



(連結) (Consolidated)		2008/3	2009/3	2010/3	2011/3	2011/9
決算期						
キャッシュフロー	Cash flows					
営業活動によるキャッシュフロー	Sales activities	2,587	606	2,494	5,571	1,154
投資活動によるキャッシュフロー	Investing activities	-1,083	-1,490	-290	-620	288
財務活動によるキャッシュフロー	Financing activities	-1,947	1,972	-2,733	-3,808	-1,217
現金および現金同等物期末残高	Cash and cash equivalents	3,351	4,399	3,836	4,933	5,080
設備投資額	①Capital expenditures	1,508	1,296	236	578	367
対売上比率	②Ratio of sales	5.86	11.19	1.65	2.56	4.70
減価償却費	③Depreciations	1,227	1,315	1,309	1,170	547
対売上比率	④Ratio of sales	4.76	11.36	9.17	5.18	7.00
研究開発費	⑤Research and development expenses	747	266	145	330	132
対売上比率	⑥Ratio of sales	2.90	2.30	1.02	1.46	1.69

(単位: 百万円/¥Millions)

2010/9
2,604
-238
-2,564
3,551
285
2.27
577
4.60
206
1.64

この資料に関するお問い合わせ

TOWA株式会社 企画部

〒601-8105 京都市南区上鳥羽上調子町5

Tel : 075-692-0251

Fax: 075-692-0270

http://www.towajapan.co.jp/contact/i_ir/index.htm

本資料には当社グループの計画や方針、財務、技術、製品、サービス、業績等に係る将来予想に関する記述が含まれております。将来予想に関する記述は、あくまで当社グループが現時点において入手可能なデータや仮定、方法等に基づき、当社グループが判断したものであり、様々なリスクや不確定な要因を含んでおります。また、新たなリスクや不確定要因は随時生じるものであり、その発生や影響を予測することは不可能であります。したがって、本資料に含まれる将来に関する記述は、実際の結果とは大きく異なる可能性があることをあらかじめご了承ください。